

证券代码：300776

证券简称：帝尔激光

武汉帝尔激光科技股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2026-001

投资者关系 活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input checked="" type="checkbox"/> 其他 电话会议
参与单位名称	长江证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、天风证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、碧云资本管理有限公司、景顺长城基金管理有限公司、开源证券股份有限公司、财通证券股份有限公司、博时基金管理有限公司、国泰海通证券股份有限公司、青骊投资管理（上海）有限公司、鹏华基金管理有限公司、光大理财有限责任公司、中邮保险资产管理有限公司、中银基金管理有限公司、江海证券有限公司、广东正圆私募基金管理有限公司、中银国际证券股份有限公司、耕霖（上海）投资管理有限公司、冯源（宁波）私募基金管理有限公司、爱建证券有限责任公司、深圳市凯玄投资有限公司、上海明策智达企业管理咨询有限公司、大通证券股份有限公司、中国人寿保险（集团）公司、上海顺领资产管理中心（有限合伙）、东北证券股份有限公司、上海申银万国证券研究所有限公司、上海益和源资产管理有限公司、光大证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司、国海证券股份有限公司、上海细水投资管理有限公司、江西省金控投资集团有限公司、长江证券（上海）资产管理有限公司、浙江浩期私募基金管理有限公司、国联安基金管理有限公司、中银国际研究有限公司、深圳市珞瑜私募证券投资基金管理有限公司、平安基金管理有限公司、上海益昶资产管理有限公司等 101 家机构及相关人员。
时间	2026 年 3 月 31 日 15:30-16:30
地点	线上电话会议、公司会议室。

<p>上市公司接待人员姓名</p>	<p>董事长、总经理李志刚先生 董事、副总经理段晓婷女士 财务负责人、董事会秘书刘志波先生 证券事务部乔端先生</p>
<p>投资者关系活动主要内容介绍</p>	<p>武汉帝尔激光科技股份有限公司（以下简称“公司”）在微纳级激光精密加工领域深耕多年，主营业务是激光精密微纳加工解决方案的设计及其配套设备的研发、生产和销售，目前下游应用领域主要覆盖全应用场景下的光伏行业，是国内首次将激光技术导入光伏太阳能电池路线的国家高新技术企业。</p> <p>公司瞄准新基建带来的广阔市场机遇，以智能制造装备为主业，聚焦光伏及作为智算核心的信息基础设施的核心装备需求，积极布局“第二增长曲线”，持续研发先进封装、化合物半导体、新型显示等领域的激光加工设备，构建“光伏主营业务为基础、半导体业务为延伸、持续布局前瞻技术与产品、配套服务为支撑”的持续发展的业务体系。</p> <p>公司聚焦光伏电池及组件全流程加工需求，覆盖BC、TOPCon、HJT、钙钛矿、PERC等全系技术路线，是光伏龙头企业的核心设备供应商。公司在技术上持续创新，在TOPCon工艺上创新局部结、TCP、TCL、激光烧结等技术工艺，在BC工艺上除量产的激光微刻蚀和铜电镀技术外创新激光晶化技术，在组件技术上创新激光整版焊、背板互联技术，在HJT工艺上开发激光转印设备、LIA 激光修复设备、激光烧结设备，在钙钛矿工艺上开发P1-P4技术。</p> <p>公司依托超快激光技术积累，在半导体先进封装等领域上持续取得进展。公司已经完成面板级玻璃基板通孔设备出货，实现了晶圆级和面板级TGV封装激光技术的全面覆盖，客户已提出复购需求。针对PCB电子级树脂基新型功能复合材料在超高速应用场景下的应用需求，公司与多家头部企业合作，迅速推进PCB超快激光精密加工设备研发项目，目前已经完成材料验证工作，即将交付客户进行量产验证。</p>

公司在化合物半导体、新型显示的激光微纳加工领域进行了前瞻性研发及业务布局。

一、经营方面

公司2025年度完成营业收入20.33亿元，同比增长0.93%，实现净利润5.19亿元，同比下降1.59%，全年经营活动产生的现金流量净额1.16亿元，同比上升171.02%。

公司2025年度全年毛利率46.57%，同比下降0.36%，持续维持相对较高的水平，体现出公司较高的技术壁垒和议价能力。

2025年度，公司研发支出2.29亿元，同比减少18.83%，占收入比重11.28%，同比减少了2.75个百分点，主要是公司更加聚焦重点研发项目，优先保障新技术、新工艺开发工作，增强技术创新能力与产品竞争力。

2025年度净利润率25.54%，与2024年同期26.19%相比有所下降，总体变化不大。

截止2025年12月31日，公司存货15.69亿元，较年初的17.23亿元，减少了8.93%；公司合同负债14.13亿元，相较年初的17.61亿元，下降了19.78%。合同负债体现了未验收的执行中合同从客户收取款项的金额，变化与光伏行业整体情况一致。

截止2025年12月31日，公司资产负债率41.10%，相较上年末的47.67%，下降了6.57个百分点，主要为合同负债和应付账款减少所致，整体而言，公司的长期偿债能力是非常稳健的，同时，公司的流动比率和速动比率分别为3.22和2.33，较近两年进一步升高，说明公司短期偿债能力在增强。

公司在TOPCon、XBC等激光技术上，均有全新激光技术覆盖及订单实现；TGV激光微孔设备，公司已经完成面板级玻璃基板通孔设备的出货，实现了晶圆级和面板级TGV封装激光技术的全面覆盖；公司在超快固体激光技术应用方面有深厚的技术积累，结合PCB行业对高

密度多层板的需求，公司开启了PCB行业超快激光技术的应用开发，主要方向为超快激光钻孔技术的开发，持续推动技术的延伸和应用拓展。目前，超快激光钻孔设备样机正在试制中。

二、投资者互动主要内容

1.公司PCB业务布局、进展。

答：PCB市场应用空间广阔，公司在超快固体激光技术应用方面有深厚的技术积累，基于前期在光伏电池打孔技术的应用、TGV微孔技术的持续研发，结合PCB行业对高密度多层板的需求，公司开启了PCB行业超快激光技术的应用开发，主要方向为超快激光钻孔技术的开发，持续推动技术的延伸和应用拓展。公司已与多家客户进行对接，目前，超快激光钻孔设备样机试制中，有多家客户正在公司打样。

2.公司TGV设备进展。

答：TGV激光微孔设备是通过精密控制系统及激光改质技术，实现对不同材质的玻璃基板进行微孔、微槽加工，提升基板的电气性能和热性能，为后续的金属化工艺实现提供条件。公司TGV微孔设备已实现晶圆级和面板级出货，该技术也可应用于先进封装、RDL、CPO、新型显示等行业，在2026年已有小批量复购订单。

3.展望2026年BC市场趋势。

答：预计未来几年BC产能将持续增长，短期新增产能受行业政策等多方因素影响，2026年BC预计有40-50GW的新增/改扩产需求。

4.公司在光伏行业少银路线上有何布局。

答：公司积极配合客户少银化工艺，在电池端，公司有铜电镀图形化方案、应用于铜浆的激光烧结技术；在组件端，公司的激光整线焊接技术，简化了整个组件焊接流程，并通过整版焊接技术提升了焊点质量与性能，该技术具有高兼容性，能与电镀、MBB、0BB等工艺兼容，可以用更细的焊带，减少银浆耗用量，适合未来光伏薄片工艺

	<p>需求。</p> <p>5.2025年第四季度毛利率环比提升的原因是什么？</p> <p>答：2025年第四季度毛利率的环比提升主要受不同客户、不同产品结构的影响，整体毛利率仍维持在约45%左右的正常波动范围内，短期波动属于合理区间。</p> <p>6.目前PCB超快激光设备打样阶段，核心关注的指标有哪些？</p> <p>答：打样阶段核心关注的指标包括：打孔品质与精度，避免出现不一致的输出及底层损伤，确保打孔精度符合要求，以及保证后续电镀工艺的匹配性与可靠性。</p> <p>7.公司钙钛矿布局。</p> <p>答：预计在今年2季度公司交付给头部客户全新钙钛矿激光方案，除P1至P4激光划线工艺外，在钙钛矿技术路线上，公司也在叠加退火、烧结、激光转印等技术工艺。</p> <p>8.公司2025年年度报告中披露的重大合同进展某客户的“本期确认的销售收入金额” 0元，请问什么原因？</p> <p>答：本期确认的销售收入指的是报表端的营业收入，此项重大合同公司在签订合同后已陆续收到预付款、设备发货款等款项，公司也相应交付了设备，同时在积极推进该合同验收并确认收入。</p> <p>公司交流人员与投资者进行了充分的交流与沟通，严格按照有关制度规定，没有出现未公开重大信息泄露等情况。</p>
附件清单 (如有)	无。
日期	2026年3月31日